

3. 会社概要

1. 当社の経営基本方針

当社は、「たゆまず前進する技術と創意工夫によって社会に貢献すること」を経営理念としております。そして、「正しい見識を持って意欲的に即行動し新しい価値を生む」ことを行動理念とし、「ユーザーに深く感謝する精神で早く良いものを安くに徹すること」を経営方針として業務に取り組んでおります。

当社は、半導体関連事業として半導体製造後工程装置やその精密金型の開発、設計、製造及び販売を行なっており、低騒音、省エネルギー、省スペース（小型化）をコンセプトとして切断・成形、マーリング、製品検査等を対象領域とする機器を提供しております。



2. 会社の概要

商 号 株式会社 石井工作研究所
(英訳名 ISHII TOOL & ENGINEERING CORPORATION.)
本 店 大分県大分市東大道二丁目5番60号
設立年月日 昭和54年(1979年)1月5日
事 業 内 容

セグメントの名称	区分	主要営業品目
半導体関連事業	半導体関連 製造装置 及び金型	リード加工機 (BGA・CSP個片カット装置を含む) リード加工金型
	加工部品	プラスチック成型加工品 プレス加工品 金属加工部品
	電装品	マイクロコンピューター 電装装置
	その他	購入品 補修サービス
不動産・建築 関連事業	マンション 及び住宅	個人住宅・住宅用ホームエレベータ 太陽光発電装置

資 本 金 1,186,300,000円(平成27年3月31日現在)
株式の状況 会社が発行する株式の総数 30,000,000株
発行済株式総数 7,800,000株(平成27年3月31日現在)
1単元の株式数 100株
決 算 期 3月31日(年1回)
役 員 代表取締役社長 石井仁海
取締役 石井光明
取締役 重松秀信
取締役 時枝典生
監査役(常勤) 衛藤良一
監査役 姫野昭雄
監査役 伊東徳 (平成27年3月31日現在)
従業員数 242名(平成27年3月31日現在)
(従業員には、臨時従業員(準社員)を含んでおりません。)
主要取引銀行 株式会社 大分銀行 本店
株式会社 三井住友銀行 大分支店
三井住友信託銀行株式会社 大分支店



ISHII TOOL & ENGINEERING CORP.

大 株 主

(平成27年3月31日現在)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
モバイルクリエイト株式会社	千株 2,550	% 32.80
石井工作研究所 従業員持株会	911	11.73
石井見紀	453	5.83
松井証券株式会社	208	2.68
石井光明	149	1.92
石井仁海	139	1.79
株式会社大分銀行	124	1.60
日本証券金融株式会社	91	1.17
松浦兼昭	61	0.78
石井貞憲	60	0.78

(注) 持株比率は、自己株式(27,870株)を控除して計算しております。



3. 会社の沿革

年 月	概 要
昭和54年 1月	株石井工作研究所設立（資本金 10,000 千円）。前身である個人企業石井工作研究所より人員その他すべてを引継ぎ、精密金型、半導体関連製造装置の開発、設計、製造、販売を主業務とした事業開始。本社及び本社工場（旧大分工場）を大分県大分市東大道二丁目1番3号に置く。 金属及び非金属材料販売を行うため丸善通商株設立。
昭和54年 6月	数値制御による機械加工を集約するため株大分工ヌシーセンター設立。
昭和55年10月	熊本及び福岡での販売を強化するため熊本県熊本市に熊本営業所開設。
昭和56年 4月	当社及び関連会社の不動産管理のため大分県大分市に有石井工研産業設立（後、株式会社へ組織変更）。
昭和56年 5月	当社及び関連会社の不動産管理のため大分県大分市に有石井工研産業設立（後、株式会社へ組織変更）。
昭和58年12月	丸善通商株を株九栄システム（現北九州工場）に商号変更するとともに本社を北九州市門司区に移転。
昭和59年 1月	業容の拡大と合成樹脂製品製造、販売のため、大分県テクノポリス地域の指定を受けた大分県杵築市に杵築工場開設。
昭和60年 2月	関西及び関東以北での販売を強化するため、大阪事務所を大阪市北区に東京事務所を東京都新宿区に開設。
昭和61年 3月	半導体組立工程の5工程（①リードフレームからの切り離し ②足の折り曲げ ③性能テスト ④製品名などの印刷 ⑤分類）を一貫処理できる半導体自動組立装置「PTMD 300」を（財）大分県高度技術開発研究所をはじめ、大分工業高等専門学校や大分大学と共同開発。
昭和61年 8月	半導体製造用の低騒音、超小型NCモータープレスの「ソフトプレス」開発。
昭和61年11月	日本国内での販売を強化し、新製品販売促進のため東京晴海での半導体製造装置展示会“セミコン・ジャパン'86”に初めて出展。
平成 3年10月	経営の合理化と経営効率を図るため、株大分工ヌシーセンター、株九栄システム及び株石井工研産業を吸収合併。
平成 4年 3月	当社の「ソフトプレス」を使った半導体の後工程一貫製造装置が、「第4回中小企業優秀新技術・新製品賞」（協和（現りそな）中小企業振興財団・日刊工業新聞共催）を受賞。
平成 4年 9月	「IC検査用画像処理装置」を開発。
平成 5年 7月	アメリカでの世界最大の半導体製造装置展示会“セミコン・ウエスト'93”に初めて出展。
平成 5年 9月	本社ビル完成。
平成 7年 4月	大阪事務所及び東京事務所を各々営業所に名称変更。
平成 8年 8月	当社株式を日本証券業協会の店頭売買有価証券として登録。
平成 9年 2月	ISO9001認証取得及びCEマーキングライセンス権取得。
平成12年 8月	ISO14001認証取得。
平成13年 6月	北九州工場を北九州市小倉北区に土地・建物を取得して移転。
平成13年 8月	不動産事業を開始。
平成14年 1月	浄水事業を開始。
平成15年11月	大分曲工場第一期工事完成。
平成16年12月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
平成17年12月	大分曲工場第二期工事完成。
平成18年 2月	大分工場、大分羽田工場の大分曲工場移転完了
平成18年 7月	本店所在地を大分県大分市東大道二丁目5番60号に住所表示変更。
平成21年 4月	北九州工場及び大阪営業所を閉鎖。

年 月	概 要
平成21年 6月	東京営業所を東京都港区の新築自社店舗に移転。
平成22年 4月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所 JASDAQに上場。
平成25年 4月	閉鎖していた北九州工場を売却。
平成25年 7月	東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード)に上場。
平成26年 5月	当社創業者 石井見敏氏逝去。
平成27年 5月	大分羽田工場を売却。

4. 営業所及び工場

① 本 社 大分県大分市東大道二丁目5番60号

② 営 業 所

東京営業所 東京都港区

熊本営業所 熊本県熊本市

③ 工 場

大分曲工場 大分県大分市

杵築工場 大分県杵築市